

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于披露发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大风险提示：

1.北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日披露的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者注意投资风险。

2.截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在持续推进过程中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

3.根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。

一、本次交易的情况

公司拟通过以发行股份方式向深圳高灯计算机科技有限公司购买安徽驿路微行科技有限公司51%股权，并向实际控制人李柠先生全资控股公司北京智耘贰零科技有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，

公司股票（证券简称：汉邦高科，证券代码：300449）自 2025 年 3 月 14 日（星期五）开市时起开始停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-014）、于 2025 年 3 月 20 日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-015）。

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于 2025 年 3 月 28 日（星期五）开市起复牌。公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 23 日、2025 年 6 月 23 日、2025 年 7 月 23 日、2025 年 8 月 22 日披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2025-039、2025-042、2025-050、2025-054、2025-058）；2025 年 9 月 18 日公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告暨未发出召开股东大会通知的专项说明》（2025-063）。

公司于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。公司于 2025 年 10 月 17 日、2025 年 11 月 17 日、2025 年 12 月 17 日、2026 年 1 月 16 日、2026 年 2 月 13 日、2026 年 3 月 13 日披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2025-067、2025-075、2025-081、2026-002、2026-004、2026-008）。

公司于 2026 年 3 月 31 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联

交易预案（修订稿）》及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。公司于 2026 年 4 月 13 日、2026 年 5 月 13 日、2026 年 6 月 12 日、2026 年 7 月 10 日、2026 年 8 月 7 日披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2026-012、2026-028、2026-030、2026-032、2026-033）。

三、本次交易的进展情况

本次交易预案披露后，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，因标的公司的财务数据已过有效期，相关中介机构正在对标的公司进行加期审计、评估和补充尽职调查工作，目前相关工作已接近尾声。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，另行发布召开股东大会的通知，提请股东会审议本次重组相关议案，并按照相关法律法规的规定履行后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。后续公司将根据交易进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 7 日